

ULTRAVIOLET C LIGHT EMITTING DIODE(UV-C LED) PKG

赤外線リフロー方式のはんだ付け推奨条件

Recommended Soldering Conditions of Infrared Reflow

[温風、赤外線+温風リフローを含む]

[Hot Air, Infrared + Hot Air Reflow Included]

KMR-CEF-0602

1/1

2018年 9月 11日

中央電子工業株式会社

電子デバイス事業部

Chuo Denshi Kogyo Co., Ltd

Electronic Devices Division

赤外線リフロー方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.

- ・ 最高温度 (パッケージ表面温度) : 260°C以下
Peak temperature (package surface temperature) : 260°C or below
- ・ 最高温度の時間 : 10sec 以内
Time at peak temperature : 10seconds or less
- ・ 220°C以上の時間 : 60sec 以内
Time at temperature of 220°C or higher : 60seconds or less
- ・ プリヒート温度 (120~180°Cの時間) : 120±30sec
Preheating time at 120 to 180°C : 120±30seconds
- ・ 最多リフロー回数 : 3 回
Maximum number of reflow processes : 3 times
- ・ ロジン系フラックスの塩素含有量 : 0.2% (Wt.) 以下
Maximum chlorine content of rosin flux (% mass) : 0.2% (Wt.) or below

